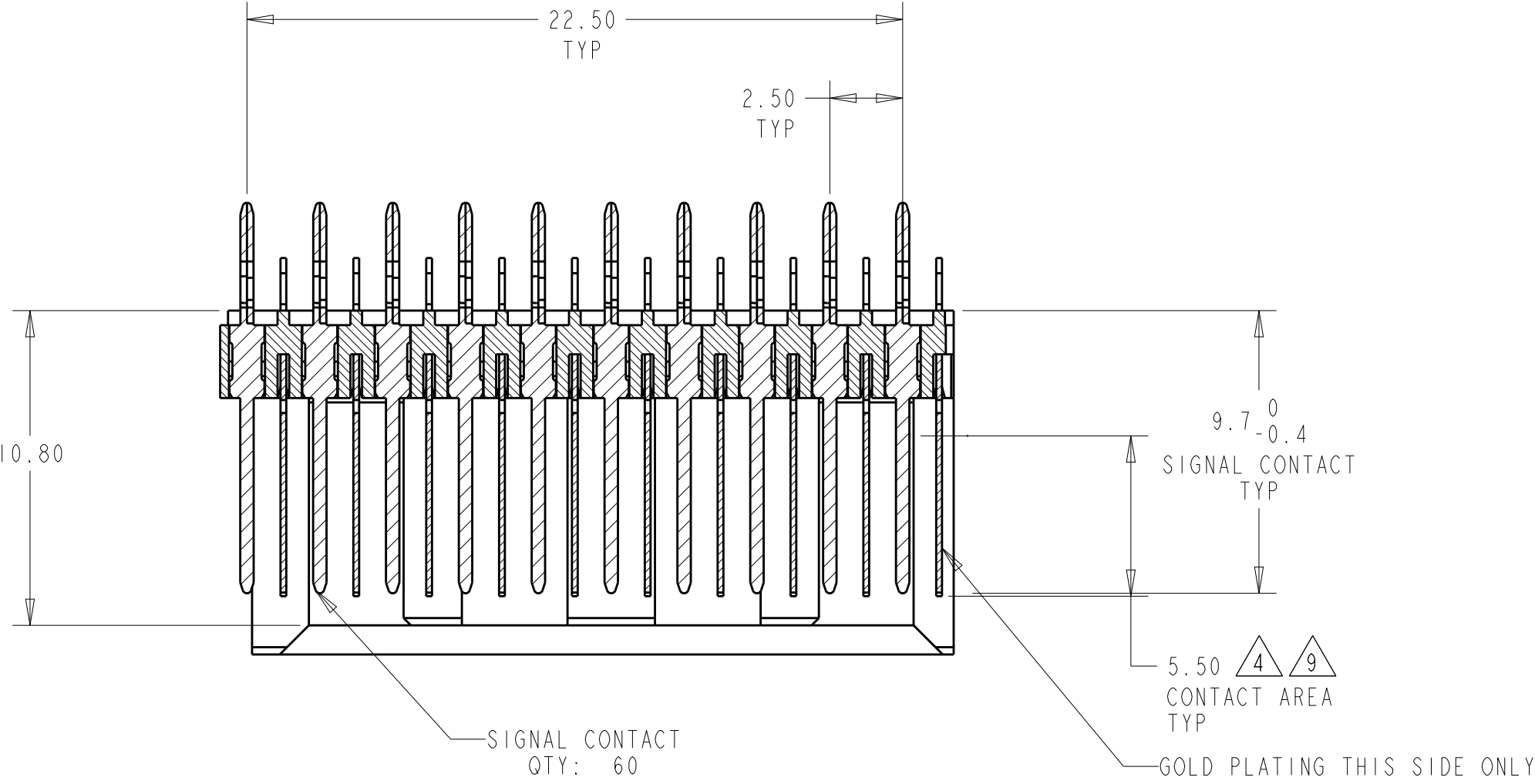
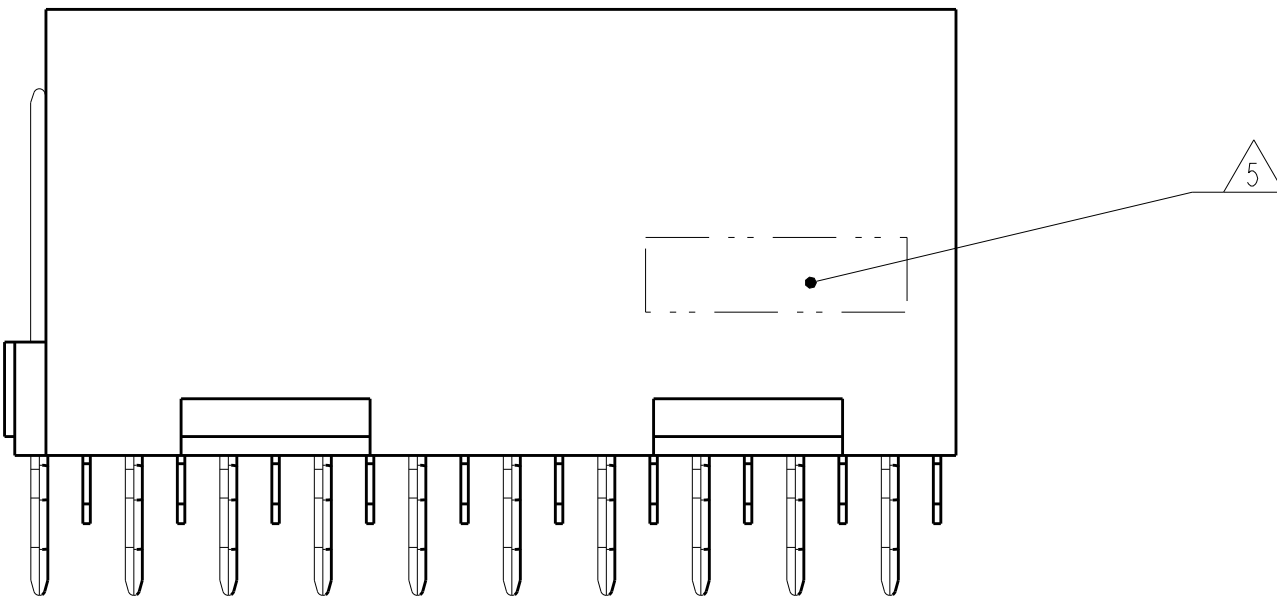
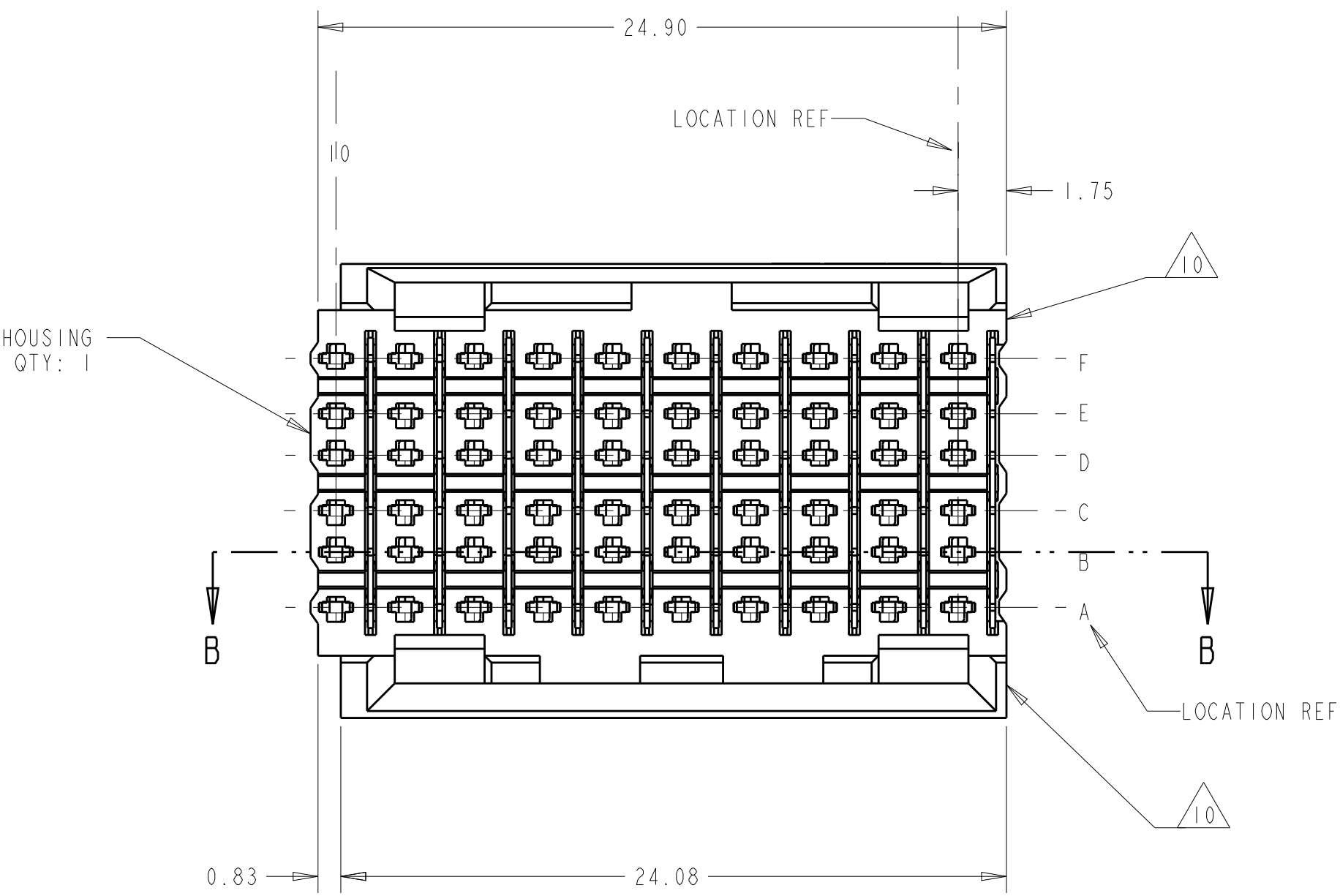


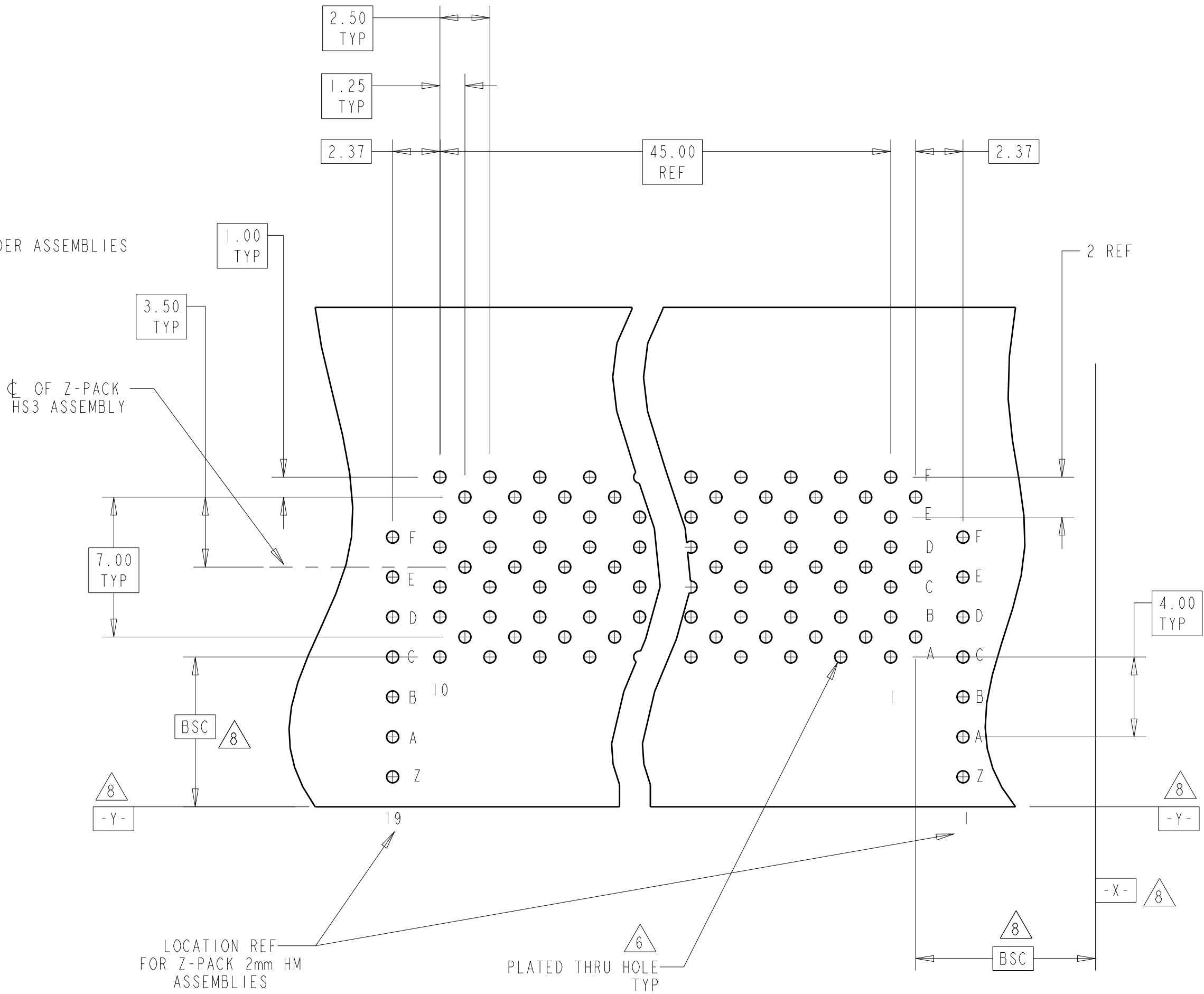
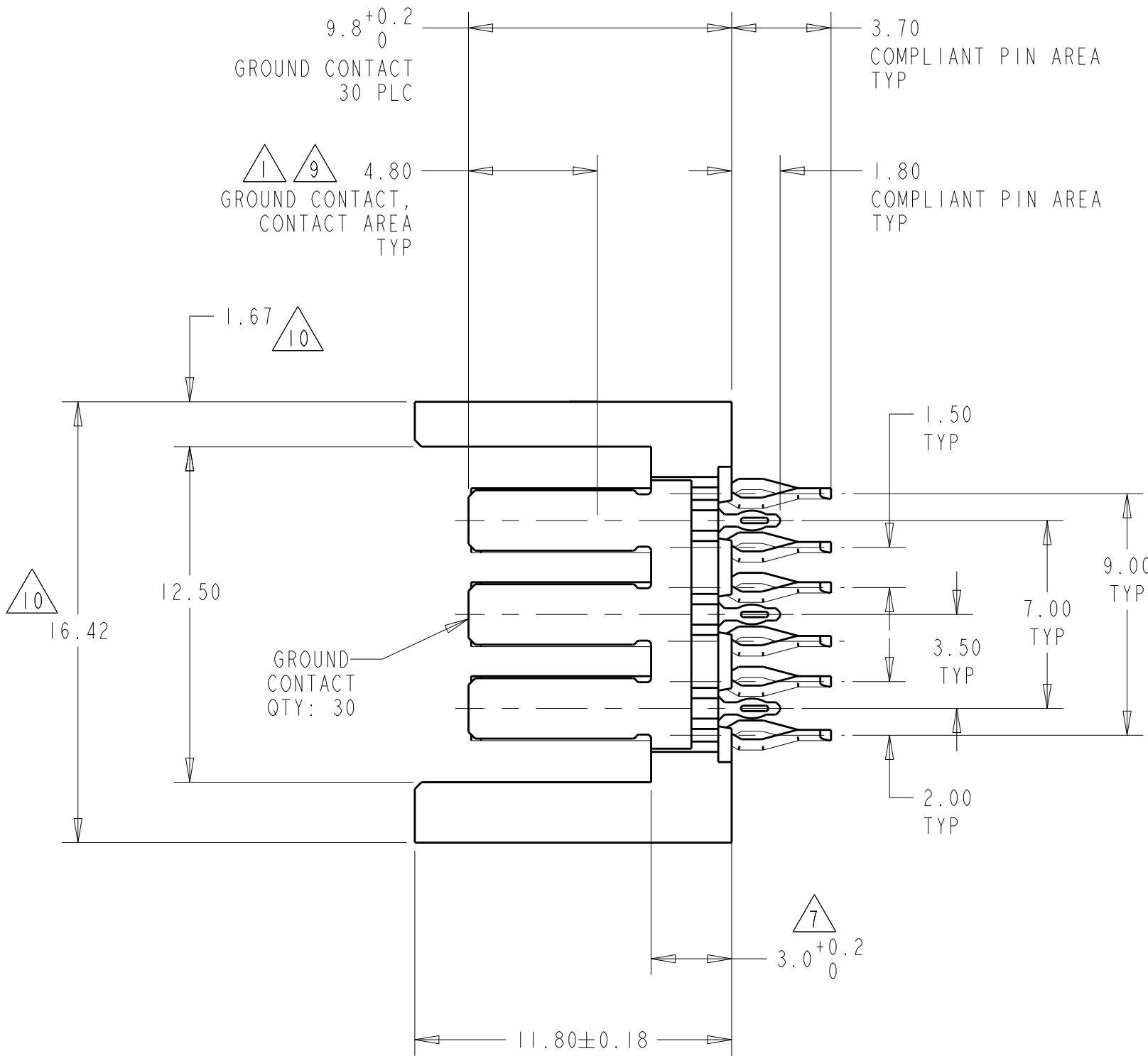
LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		B	REVISED PER ECO-12-006972	23AUG2012	KH	JE



SECTION B-B



- 1 FINISH: CONTACT MATING AREA MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPECIFICATION 108-1957; BASED ON TELCORDIA GR-1217-CORE, APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS. COMPLIANT PIN AREA: 0.5µm MIN MATTE TIN OVER BASE PLATING.
- 2 PHOSPHOR BRONZE
- 3 GLASS FILLED POLYESTER
- 4 0.76µm MIN GOLD OVER 1.27µm MIN NICKEL ON CONTACT AREA
0.76µm MIN TIN OVER 1.27µm MIN NICKEL ON COMPLIANT PIN AREA
- 5 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE
- 6 REFERENCE APPLICATION SPEC 114-13020 FOR RECOMMENDED PLATED THRU HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 7 APPLICATION SEATING HEIGHT TO PRINTED CIRCUIT BOARD
- 8 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER
- 9 CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT
TECHNICAL REFERENCE: GR-1217-CORE, ISSUE 1, NOVEMBER 1995
- 10 THIS Z-PACK HS3 HEADER IS SPECIFICALLY DESIGNED TO FIT TWO (2) HEADER ASSEMBLIES IN THE P4 POSITION ON A 20mm SLOT PITCH AGAINST Z-PACK 2mm HM 5 ROW HEADER ASSEMBLIES FOR CompactPCI



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN B. CARBO	08DEC04	 TE Connectivity		
			CHK R. PATTERSON	08DEC04			
			APVD R. PATTERSON	08DEC04			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			NAME HEADER ASSEMBLY, 60 POSITION, BACKPLANE CONNECTOR, 6 ROW, Z-PACK HS3 FOR CompactPCI		
mm		0 PLC ±					
		1 PLC ±0.13					
		2 PLC ±0.05					
		4 PLC ±			SIZE A1		
		ANGLES					
MATERIAL		FINISH GROUND CONTACT:			CAGE CODE 00779		
HOUSING: 3		CONTACT: 4					
CONTACTS: 2		SIGNAL CONTACT: 4			DRAWING NO 5120826		
					SCALE 5:1		
					SHEET 1 OF 1		
					REV B		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9